



2026年4月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド  
代 表 者 名 代表取締役社長(COO 兼 CFO) 山 本 正 幸  
(コード番号：6521 東証グロース)  
問 合 せ 先 執行役員(CSO)企画本部長 竹 内 健 吾  
(TEL： 0551-26-0022)

### 2026年2月期 通期 決算説明会の質疑応答（要旨）について

当社は、昨日決算説明会（アナリスト・機関投資家向け）を開催いたしました。ご出席の皆様からいただいた主なご質問を以下にまとめております。なお、理解促進のため、一部加筆修正を行い要旨として記載をしております。

- Q. 2026年2月期の売上高は100億4,000万円と100億円を突破した一方で、2027年2月期の売上高予想は98億2,900万円と、前期比で減収見込みとなっています。なぜトップラインがマイナス成長になるのか、背景を教えてください。
- A. ご指摘の売上高の推移については、当社の成長が鈍化したのではなく、Raicol社連結除外の影響によるものです。2026年2月期は、新領域事業売上高の約半分が株式譲渡前のRaicol社売上高で構成されていました。当社は2026年2月にRaicol社株式譲渡により非連結化として、2027年2月期予想にはRaicol社売上高を含んでおりません。そのため、2027年2月期の連結売上高は、98億2,900万円と前期比でほぼ横ばいとなります。
- 一方で、OXIDE単体の売上高は引き続き力強い成長を見込んでおり、前期約86億円から今期約98億円と、前期比約15%の増収を計画しています。

Q. AI データセンター向けの後工程投資が世界的に加速し、国内でも光電融合や先端パッケージング領域の動きが強まっています。こうした環境下で、オキサイドは半導体後工程や光電融合分野にどのように参入していくのでしょうか。先日、ニュースリリースがありました。具体的には、どの技術を強みにし、外部連携を通じてどのような製品・ソリューションを展開していくのか教えてください。

A. 当社は、半導体後工程や光電融合に用いるレーザ微細加工技術の事業を加速するため、台湾のレーザ加工機メーカーである Bolite 社と業務提携いたしました。

現在、急増している AI データセンターでは、通信量や消費電力増大の問題が顕在化しており、その解決策として、半導体後工程や光電融合の技術に注目が集まっています。この領域では、従来の機械加工を超えたレーザによる微細かつ高精度な加工が求められています。

当社はこれまで、半導体分野で深紫外レーザ技術を強みとして事業を展開してきました。一方、Bolite 社はレーザ微細加工技術や加工装置化技術を強みとし、台湾を中心に顧客ネットワークを開拓してきました。

今回の業務提携により、高精度のレーザ微細加工装置の開発・製品化が可能となり、後工程・光電融合領域を代表とする微細加工市場に本格参入できる体制が整いました。

具体的な応用領域としては、ガラス基板および SiC インターポーザーの微細加工、マイクロ QRコードマーキング、光電融合に向けたデバイス加工、ダイヤモンドウエハの平坦化や CMP 基板に対応した高精度加工など、当社のレーザ技術の強みが発揮できる応用領域に注力していきます。

当社は単結晶・レーザ技術の中核に据え、他社との積極的な連携により、中期的な柱となる事業への成長を目指します。

質疑応答

## 半導体 | 半導体後工程向け微細加工事業

OXIDE

- 半導体後工程・光電融合向けレーザ微細加工事業への参入を目指し、戦略的パートナーとして台湾のレーザ加工装置メーカー Bolite 社と業務提携いたしました(2月16日)。
- 急増する AI データセンターでは GPU 間通信量の増加により、帯域不足、消費電力増大などの問題が発生しています。対策として、半導体後工程ではパッケージの高密度接続と熱管理、さらに光電融合による低消費電力で超高速光インターコネクタの実現が急務となっています。
- この現状の課題を解決するには状況に対応には従来技術では実現できない非接触・低ダメージな高精度加工が求められており、台湾 Bolite 社との連携を通じて、以下の事業化に取り組みます。

事業化を目指すレーザ微細加工の応用

- ・ ガラス基板および SiC インターポーザー向けの微細加工
- ・ 高信頼トレーサビリティを実現するマイクロ QRコードマーキング
- ・ 光電融合に代表される次世代デバイス向け加工ソリューション
- ・ ダイヤモンドウエハの平坦化や CMP 基板に対応した高精度加工

OXIDE × BOLITE  
博 隆 精 密



レーザ微細化加工装置

Q. 先月開示された新製品の量子向けレーザに対する質問です。オキサイドのレーザは、量子コンピュータにどのように使われるのでしょうか。また競合他社に対してどのような強みがあるのでしょうか。詳しく教えてください。

A. 当社はこれまで、量子もつれ光子対を発生する波長変換素子を中心に、量子分野での事業を開拓してまいりました。今回、半導体市場で培った高出力・高信頼性レーザ技術を競争力として、量子コンピュータ用レーザ事業に本格的に参入いたしました。

現状の量子コンピュータの開発状況ですが、当初は超伝導方式が先行していましたが、最近では量子ビット数の拡張性など大規模化に有利な中性原子方式への注目が高まっています。先日、超伝導方式を先導してきた Google が、新たに中性原子方式の開発にも参入することを発表しています。

中性原子方式では、複数波長のレーザを用いて原子の操作を行い、量子計算を実行します。そのため、多波長・高出力・高信頼性を兼ね備えたレーザが重要な要素となっています。特に、量子コンピュータが産業化を目指した開発へ移行しつつあり、当社が半導体市場で培った高い安定性を有するレーザが注目される状況になりました。

中性原子方式の量子コンピュータは多くの波長のレーザを必要とします。また、計算には数多くの原子を同時に操作するために、原子数に応じた高いレーザ出力が求められます。

当社は、波長変換により幅広い波長の発生技術を強みとしていますが、波長変換のもとになる基本波レーザも重要な要素となります。

そのため、当社は基本波となる高出力半導体レーザに強いフィンランドの VEXLUM 社と戦略的パートナーシップを締結しました。両社の技術を組み合わせることにより、量子コンピュータに求められる広い波長領域で動作する高出力レーザの製品化が可能となりました。その第一弾の成果として、最先端の Yb 中性原子型中性原子コンピュータ向けに 302 nm 高出力レーザ光源を製品発表しました。

紫外線領域での高出力化は難しいのですが、当社製品は 500 mW 以上の高出力と 10,000 時間以上の長寿命を達成し、世界トップの性能を実現しました。

特に 302 nm の波長は、Yb を用いる量子コンピュータにおいて量子演算の中核を担うレーザ波長です。このため、この製品発表以降、すでに複数の量子コンピュータ開発企業から高い評価をいただいています。

今後は、量子コンピュータで必要とされる幅広い波長領域で製品ラインナップを拡充し、量子分野での事業拡大を進めてまいります。

質疑応答

## 新領域 | 量子市場の現状と当社の事業

OXIDE

- 当社の量子関連事業は、先行する波長変換素子に加え、量子コンピュータ用レーザ事業に参入いたしました。半導体市場で培った高出力・高信頼化技術を競争力とし、新たな市場での事業拡大を目指します。

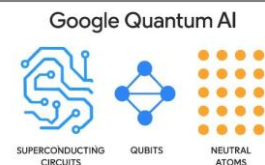


- 量子コンピュータ開発が基礎研究から産業化への移行期つつあります。各方式の開発が進む中、「中性原子方式」へ注目が集まっています。(3月24日、Google Quantum AI社が、従来より開発していた超伝導方式に加え中性原子方式の開発開始を発表しました)。中性原子方式は、複数のレーザで原子を冷却・整列し量子ビットとして用いるコンピュータであり、大規模化に有利な方式です。当社は本方式に使用するレーザの事業化を推進します。

### 量子コンピュータの各種方式と特長

方式	主要プレイヤー	量子ビット	特長
超伝導	IBM, Google, 富士通	超伝導回路	高速計算
中性原子	QuEra, Pasqal, NanoQT, Yaqumo	中性原子	大規模化
イオントラップ	IonQ, Quantinuum, AQT	イオン	計算精度
光量子	Xanadu, OptQC, NTT	光子	室温動作

### Googleによる「超伝導×中性原子」の発表



Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

30

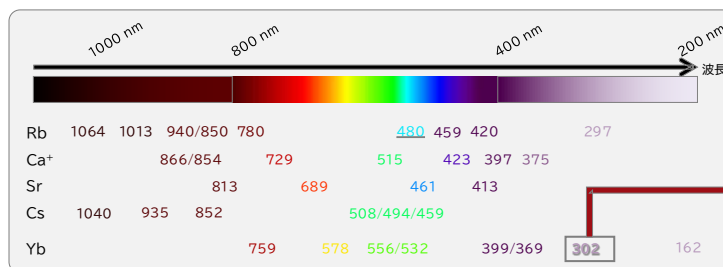
質疑応答

## 新領域 | 量子用コンピュータ用レーザ事業

OXIDE

- 量子コンピュータは多くの波長のレーザを必要とします。当社は量子コンピュータ用レーザ事業への本格展開を目的とし、フィンランドの半導体レーザメーカー・VEXLUM社と戦略的パートナーシップを締結しました。当社の強みである波長変換技術とVEXLUM社の高出力半導体レーザ技術を組み合わせることにより、サイズ、出力、対応波長の制約を克服する新しい量子コンピュータ用レーザを創出いたします。
- 本事業の第一弾の製品として、最先端のYb中性原子型量子コンピュータにおいて量子演算の重要な役割を担う302nm高出力レーザを製品発表いたしました。このレーザは深紫外領域の高出力化が難しい波長において世界トップの出力と長寿命化を実現しており、既にコンピュータを開発している各社からの引き合いを頂いております。
- 今後は、量子コンピュータで必要とされる幅広い波長領域へ製品ラインナップを拡充してまいります。

### 量子コンピュータで用いる原子・イオンとレーザの波長



### VEXLUM社と戦略的パートナーシップを締結

OXIDE × VEXLUM

### 量子コンピュータ用302nmレーザ



Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

31

Q. ここ最近のニュースを見ますと、パワー半導体メーカーの統合・再編の動きが活発化しています。こうした市場環境の変化を踏まえて、溶液法による SiC ウェハ事業の現在の進捗と、ターゲットとしている具体的なアプリケーション領域について教えてください。

A. SiC ウェハ事業の進捗についてご説明します。当社グループのオキサイドパワークリスタル社では、独自の溶液法を用いた 6 インチ p 型 SiC ウェハの開発に成功し、すでに複数の顧客へサンプル出荷を開始しています。

現在、再生可能エネルギーの導入拡大や AI 普及に伴うデータセンターの電力需要増を背景に、電力インフラへの投資が世界的に加速しています。加えて、国内外ではパワー半導体メーカーの統合・再編が進み、サプライチェーンの再構築が大きなテーマになっています。こうした環境下で、当社が提供する p 型 SiC ウェハは、超高耐圧領域のデバイスに不可欠な材料として、存在感が高まっています。

具体的なアプリケーションとしては、まず HVDC（直流送電）が挙げられます。長距離・大容量を高効率で送電する HVDC の導入が加速しており、ここでは従来のシリコンでは対応が難しい超高耐圧デバイスが求められています。

また、最近、急拡大している AI データセンターでは、800V DC 配電への移行が進み、高効率・高密度な電力変換を実現する SST（Solid State Transformer）が注目されています。これらの領域では、次世代デバイスとして SiC IGBT が有力視されており、その実現には高品質な p 型 SiC ウェハが不可欠です。

当社は、溶液法という独自技術によってこの領域に参入できる数少ない企業です。HVDC やデータセンター向け SST を含む次世代電力インフラのサプライチェーンにおいて、確かな材料供給者としてのポジションを確立すべく、事業化を加速してまいります。

質疑応答

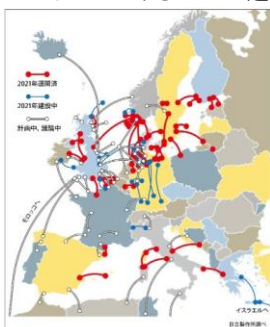
## 新領域 | SiC 事業の進捗

OXIDE

- オキサイドパワークリスタル社は、6インチp型SiCウェハの開発に成功し、顧客へのサンプル出荷を開始しました。※1
- HVDC（直流送電）やデータセンターSST向けで、超高耐圧パワー半導体SiC IGBTの立ち上がりが期待されています。
- 当社は、SiC IGBTの実現に不可欠なp型SiCウェハの提供を通して、次世代電力サプライチェーンにおいて不可欠な存在となることを目指します。

### SiC IGBTの市場機会

#### ヨーロッパにおけるHVDC送電網



国際環境経済研究所Webサイト  
<https://ieei.or.jp/2023/05/santo.20230518/>

#### データセンター向け配電の流れとSiC IGBTの市場機会



※1 本成果は、NEDOグリーンイノベーション基金事業「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトの一環として実施されたものです。メンバーは株式会社オキサイドパワークリスタル、マイボックス株式会社、株式会社UJ-Crystal、アイクリスタル株式会社、産業技術総合研究所、名古屋大学です。

Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

32

Q. 2026年2月期通期実績の営業利益5億4,200万円について、会社別（OXIDE・OPC・Raicol）の内訳を教えてください。また、2027年2月期予想の営業利益9億3,300万円についても、同様に内訳を教えてください。

A. 2026年2月期実績の連結営業利益5億4,200万円については、連結に関わる各種調整を含んでいるため、各社の単純合計とは一致しません。その前提で、各社ベースのおおよその内訳としては、OXIDE単体が約12億円弱、OPCが約▲3億円、Raicolが約▲3億円となっており、これらに連結調整を加えた結果、連結営業利益は5億4,200万円となっております。  
2027年2月期予想については、OXIDE単体が約13億円、OPCが▲4億円程度を見込んでおり、連結営業利益9億3,300万円を計画しております。

Q. 半導体事業について、過去に不具合が発生していた主要部品の歩留まりは足元でどのような状況でしょうか。また、先日プレスリリースした193nmの新製品の動向、次世代レーザの開発受託の内容、そしてメンテナンス需要の見通しを教えてください。

A. まず、主要部品の歩留まりについては、新たなベンダーへの切り替え後も100%を継続しており、足元では安定した推移となっております。193nmの新製品については、12月のリリース以降、複数の引き合いをいただいております。詳細は顧客との関係で開示できませんが、今期の売上計画には一定程度の寄与を見込んでおります。  
次世代レーザの開発受託案件についても、守秘義務の関係で個別の内容は開示できないものの、将来の売上に段階的に寄与していくものと認識しております。  
メンテナンス需要については、実際の需要水準は顧客の使用状況等にも左右されますが、新規レーザ製品の出荷が進み累積出荷台数が増加することで、全体として増加基調が継続すると見ております。

Q. 新領域事業の2026年2月期通期売上高における、データセンター向けファラデー回転子の売上高はどの程度でしょうか。同様に、2026年2月期第4四半期における売上高、ならびに2027年2月期の売上高見通しを教えてください。

A. 2026年2月期通期実績では、新領域事業の予想比増収約10億円のうち、相当部分をデータセンター向けファラデー回転子の売上高が占めております。また、第4四半期においては、当該増収分のうち約半分弱がファラデー回転子向けとなっております。  
2027年2月期のファラデー回転子の売上高については、当社にとって新たな事業、新たな顧客であることを踏まえ、顧客の受注見通しを確認した範囲で策定しており、2026年2月期実績から微増程度と保守的に見込んでおります。

Q. 中期経営目標において、営業利益率および EBITDA マージンを前倒しで達成する計画とされていますが、その要因について教えてください。

A. 売上高については、Raicol 社株式譲渡により、前期計上していた Raicol 社の売上高が全てなくなります。しかしながら、OXIDE 単体の半導体事業および新領域事業の成長により、それを補完し、2029 年 2 月期の売上目標は 130 億円から変更いたしません。

収益性については、既存事業が堅調に推移していることに加え、データセンター向けファラデー回転子や量子コンピュータ用レーザなどの新領域事業や、現在顕在化しつつある高付加価値の新規事業を段階的に積み上げていくことで、営業利益率および EBITDA マージンについても、中期経営目標の前倒し達成を目指します。

以上